

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

04-003438

(43) Date of publication of application :

08.01.1992

(51) Int. Cl.

H01L 21/52

H01L 23/29

H01L 23/31

(21) Application number : 02-102904

(22) Date of filing : 20.04.1990

(71) Applicant : OKI ELECTRIC IND CO LTD

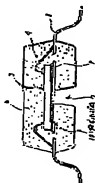
(72) Inventor : TAKEJI SHINJI
YAMADA SHIGERU

(54) HIGH HEAT-RESISTANT RESIN-SEALING TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent a package from being deformed or cracked due to heating exceeding 200-C when packaging a substrate by using an organic macromolecular adhesive with a specific elasticity modulus of an adhesive-curing substance and a specific rate of moisture absorption under specific conditions.

CONSTITUTION: Five kinds of epoxy resins with different composition and a polyimide resin are used as a die-bonding material 10 for adhesion and resin-sealing is performed for production in die bonding of a semiconductor chip 3 on an island 2 of a lead frame, where elasticity modulus of an adhesive-curing agent exceeding 200-C is equal to or larger than 47109dyn/cm² and a rate of moisture absorption after leaving for 72 hours at 85-C/85% R.H. (relative humidity) is equal to 0.2% or smaller.



特許庁	特許第 3438 号	発明の名称	高温耐熱樹脂封止型半導体装置
出願番号	02-102904	発明の要旨	本発明は、半導体チップ(3)をリードフレーム(2)の島(2)上に接合する際に、有機高分子接着剤を用いることにより、加熱による変形やクラックを防止する半導体装置に関する。
発明の要旨	本発明は、半導体チップ(3)をリードフレーム(2)の島(2)上に接合する際に、有機高分子接着剤を用いることにより、加熱による変形やクラックを防止する半導体装置に関する。	発明の要旨	本発明は、半導体チップ(3)をリードフレーム(2)の島(2)上に接合する際に、有機高分子接着剤を用いることにより、加熱による変形やクラックを防止する半導体装置に関する。
発明の要旨	本発明は、半導体チップ(3)をリードフレーム(2)の島(2)上に接合する際に、有機高分子接着剤を用いることにより、加熱による変形やクラックを防止する半導体装置に関する。	発明の要旨	本発明は、半導体チップ(3)をリードフレーム(2)の島(2)上に接合する際に、有機高分子接着剤を用いることにより、加熱による変形やクラックを防止する半導体装置に関する。

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C) 1998, 2000 Japanese Patent Office